

证券简称：灿芯股份

证券代码：688691

灿芯半导体（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者交流）
参与单位名称	国金证券、申万宏源证券、东北证券、银华基金、浙商资管、乘是资产、见合私募基金、弥远投资、璞远资产、汐泰投资、湘禾投资、胤胜资管、原点资管、重阳投资
时间	2024年9月24日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	庄志青先生 董事长兼总经理 沈文萍女士 董事会秘书
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>公司董事长兼总经理庄志青先生对公司 2024 年 1-6 月的经营情况进行了简要介绍：</p> <p>2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 5.94 亿元，同比减少 10.94%；归属于上市公司股东的净利润为 8,043.34 万元，同比减少 25.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,155.10 万元，同比减少 24.71%。</p> <p>公司业绩有所下降的原因主要系报告期内受下游客户需求波动影响，同时出于长远发展考虑，为进一步巩固和加强自身核心竞争力，公司积极推进募投项目实施，持续加大产品与技术开发力度及研发技术团队建设投入，研发费用同比增加 37.24%，从而使得公司报告期内净利润等相关指标同比有所下降。与此同时，随着公司本期芯片全定制服务收入占比的上升，公司综合毛利率较上年同期增加 3.59 个百分点，为 31.04%。</p> <p>投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：</p> <p>1、公司 2024 年上半年营业收入情况以及变动原因？</p>

答：按业务类型来看，公司 2024 年 1-6 月芯片设计业务收入为 10,885.28 万元，较去年同期下降 59.18%，芯片量产业务收入为 48,517.39 万元，较去年同期增长 21.20%。按服务类型来看，公司 2024 年 1-6 月芯片全定制服务收入为 42,736.97 万元，较去年同期增长 15.70%，芯片工程定制服务收入为 16,665.70 万元，较去年同期下降 44.00%。公司 2024 年 1-6 月收入下降主要原因是受下游客户需求波动影响。

2、请问公司 2024 年 1-6 月的研发投入和研发人员情况？

答：2024 年上半年，公司研发费用为 6,381.61 万元，占公司营业收入比例为 10.74%，较上年同期增加了 37.24%。公司截至 2024 年 6 月末共有研发人员 130 人，较上年同期末研发人员增加 35.42%。

3、公司毛利率变化的主要原因是什么？

答：按服务类型来看，公司 2024 年 1-6 月芯片全定制服务收入为 42,736.97 万元，较去年同期增长 15.70%，芯片工程定制服务收入为 16,665.70 万元，较去年同期下降 44.00%，由于公司芯片全定制服务毛利率整体高于芯片工程定制服务毛利率，2024 年 1-6 月芯片全定制服务收入占比的提升也带动公司毛利率提高，公司 2024 年上半年综合毛利率较上年同期上升 3.59 个百分点，为 31.04%。

4、公司上半年研发方面取得了哪些具体的进展？

答：高速接口 IP 领域：（1）DDR：公司基于 28nm HKC+工艺的 72bit DDR、LPDDR IP 设计验证成功，最高速率达到 2,667Mbps；基于 28nm HKD 2.5V 工艺的 DDR、LPDDR IP 设计完成进入验证阶段；（2）Serdes 与 PCIE：公司基于 28nm HKC+工艺的 Serdes IP 及 PCIE IP 设计验证成功，最高速率可达 16 Gbps；（3）MIPI：公司可满足汽车电子可靠性要求的先进工艺 MIPI DPHY IP 设计验证成功，最高速率可达 2.5Gbps，同时公司基于 28nm HKC+工艺的 MIPI DPHY IP 设计验证成功，最高速率可达 4.5Gbps；（4）USB：公司可满足汽车电子可靠性要求的先进工艺 USB 2.0 IP 设计验证成功，速率可达 480Mbps。同时公司基于 28nm HKD 1.8V 工艺的 USB 2.0 IP 以及基于 28nm HKD 2.5V 工艺的 USB 2.0 IP 设计完成进入验证阶段。

模拟 IP 领域：（1）ADC：公司 40nm LL 工艺 16bit SAR ADC IP 设计验证成功，最高采样率达到 4Msps，有效位达到 14bit 以上；（2）PLL：公

	<p>司 28nm HKC+工艺 PLL IP 设计验证成功，最高速率达到 4.5GHz；同期公司 28nm HKD 1.8V 工艺 PLL IP 设计完成进入验证阶段以及基于 28nm HKD 2.5V 工艺 PLL IP 设计完成进入验证阶段。</p> <p>系统级芯片平台研发领域：（1）车规平台方面：公司基于 40nm EFlash 的车规双核锁步 MCU 平台已完功能安全相关前端和 DFT 部分的主体设计，并进入仿真验证阶段；（2）自动测试平台方面：公司已分别实现 MIPI、PCIE、DDR、ADC、RF 的自动化测试系统搭建，并在实际项目中得以应用验证，测试数据的一致性有保证，测试效率大幅度提高。</p> <p>5、公司一站式芯片定制服务的下游应用领域主要有哪些？</p> <p>答：公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市、高性能计算等行业，2024 年 1-6 月，公司营业收入按下游应用领域分类主要有消费电子（占比 29%）、物联网（占比 26%）、网络通信（占比 25%）和智慧城市（占比 13%）等。</p> <p>6、公司目前的下游客户主要有哪些，收入占比如何？</p> <p>答：从客户群体而言，公司下游客户主要为系统厂商和芯片设计公司，系统厂商是指面向终端应用提供整机系统设备的厂商；芯片设计公司是指从事自有品牌芯片产品设计研发及销售的企业。公司 2024 年上半年来自于系统厂商、芯片设计公司及其他类型客户的收入占比分别为 28.30%、69.81%和 1.89%。</p> <p>7、公司募集资金使用情况如何？</p> <p>答：截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金人民币 245.67 万元。同时公司已使用募集资金合计 3,621.27 万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 24 日
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无

